SCSPCBA 旭森智造

PCBA 组装能力

SMT & PCBA Assembly Capability

YAMAHA YSM 系列 SMT 贴装设备能力

材料类型	项目	最小值	最大值
PCB	尺寸	50*50*0.6	400*339*3
	重量		1.8KG
	特殊尺寸		590*280*3
	材料	FR-4、CEM-1、CEM-3、铝基板、FPC	
	表面处理	HAL、OSP、沉金、闪金、金手指	
元器件	Chip & IC	01005（0.4*0.2）	22*22
	特殊尺寸（连接器）	1.6*0.8	72mm
	BGA 间距	0.35mm	1.0mm
	QFP 间距	0.35mm	1.0mm

元器件类型	速度（CPH）	精度（mm）	视觉系统
1608Chip	52K/H	0.04	飞行相机
1005Chip	52K/H	0.04	飞行相机
0603Chip	52K/H	0.04	飞行相机
SOP16	30K/H	0.10	飞行相机
QFP100	20K/H	0.03	固定相机
QFP256	10K/H	0.03	固定相机
BGA	10K/H	0.03	固定相机

产品类型	数量	常规交期	加急交期
SMD+connector	5~200	6个工作日	3个工作日
SMD+connector	201~2000	7个工作日	7个工作日
SMD+connector	≥ 2000	7～9个工作日	8个工作日
SMD+DIP	5~200	5个工作日	4个工作日
SMD+DIP	201~2000	7个工作日	5个工作日
SMD+DIP	≥ 2000	8个工作日	6个工作日

备注：以上交期仅为组装生产时间。

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路229号B栋203
邮箱：sales@scspcba.com
www.aiscspcba.com
www.scspcba.com

SCSPCBA 旭森智造

YAMAHA YSM20R SMT 贴装设备能力

YAMAHA YSM20R SMT Assembly Machine Capability

材料类型	项目	最小值	最大值
PCB	尺寸	50*50*0.6	400*339*3
	重量		1.8KG
	特殊尺寸		590*280*3
	材料	FR-4、CEM-1、CEM-3、铝基板、FPC	
	表面处理	HAL、OSP、沉金、闪金、金手指	
元器件	Chip & IC	01005（0.4*0.2）	22*22
	特殊尺寸（连接器）	1.6*0.8	72mm
	BGA 间距	0.3mm	1.0mm
	QFP 间距	0.3mm	1.0mm

元器件类型	速度（CPH）	精度（mm）	视觉系统
1608Chip	52K/H	0.04	飞行相机
1005Chip	52K/H	0.04	飞行相机
0603Chip	52K/H	0.04	飞行相机
SOP16	30K/H	0.10	飞行相机
QFP100	20K/H	0.03	固定相机
QFP256	10K/H	0.03	固定相机
BGA	10K/H	0.03	固定相机

YAMAHA YSM20R

高效率、高可靠性与高灵活性

1. 微型元件贴装精度：0.035mm ± 0.025mm
2. PCB 传输效率高
3. 自动供料器
4. 百万像素视觉相机（Fly Camera、Fix Camera）
5. 防静电吸嘴
6. 最小可贴装尺寸 01005

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路229号B栋203
邮箱：sales@scspcba.com
www.aiscspcba.com
www.scspcba.com